

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2001-242471

(P2001-242471A)

(43) 公開日 平成13年9月7日 (2001.9.7)

(51) Int.Cl. ¹	識別記号	F I	マークト ² (参考)
G 0 2 F 1/1339	5 0 5	C 0 2 F 1/1339	5 0 5 2 H 0 8 8
1/13	1 0 1	1/13	1 0 1 2 H 0 8 9

審査請求 未請求 請求項の数17 O.L (全 9 頁)

(21) 出願番号 特願2000-53106(P2000-53106)

(22) 出願日 平成12年2月29日 (2000.2.29)

(71) 出願人 000115588
 ランテクニカルサービス株式会社
 東京都渋谷区代々木1丁目6番12号

(72) 発明者 松本 好家
 東京都渋谷区代々木1丁目6番12号 ラン
 テクニカルサービス株式会社内

(74) 代理人 100085419
 弁理士 大垣 孝
 Fターム(参考) 2H088 FA02 FA03 FA04 FA09 FA17
 FA30 MA20
 2H089 NA09 NA22 NA44 NA48 NA60
 QA12 QA16

(54) 【発明の名称】 液晶パネルの基板の貼り合わせ方法および貼り合わせ装置

(57) 【要約】

【課題】 一方の基板に液晶を滴下した後に他方の基板を貼り合わせる方法を実施する際に、液晶中にシール材の成分が混入しないようにする。

【解決手段】 貼り合わせ装置10は、不活性ガスで置換された雰囲気を保持可能な処理室12を具える。この処理室として、グローブボックス14の内部空間が用いられる。処理室の内部には、液晶滴下部32と基板貼り合わせ部34などで構成された装置主要部30が設けられる。液晶滴下部では、液晶パネルの主要部品である第1の基板上に液晶が滴下される。基板貼り合わせ部では、液晶滴下部で液晶が滴下された第1の基板に対して第2の基板が押圧され、シール材が硬化される。

